

積層セラミックチップコンデンサ CUシリーズ

[高周波用低ESR用]

特長

内部電極にCu(銅)を採用し、低損失(低ESR、高Q)を実現しています。

用途

通信機器などの高周波回路
高周波モジュール(パワーアンプ、VCO)等

温度補償用コンデンサ

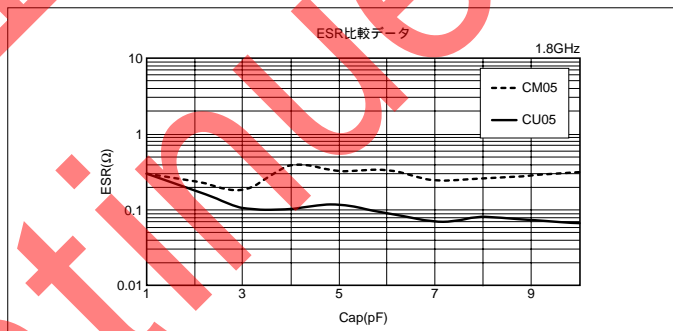
形 式	CU05 (1005)
温度特性	CΔ
定格電圧(VDC)	25
静電容量(pF)	
R20	0.2
R50	0.5
1R0	1.0
1R5	1.5
	2.0
	3.0
	4.0
	5.0
	6.0
	7.0
	8.0
	9.0
100	10
120	12
	15
	18
	22
	27
	33
	39
	47
	56
	68
	82
101	100

厚み(T)寸法規格と包装数量

対象形式	05
厚み(T)寸法規格 (mm)	B 0.5±0.05
テーピングφ180リール	10kp(P8)
テーピングφ330リール	50kp(P8)

•テーピングリールは1リール当たりの包装数量(Kpは×1000個)を表し、カッコ内のP8は紙キャリアテープ8mm幅を意味しています。

当社一般品(CMシリーズ)とのESR比較



生産中止
Discontinued Product